第2回 シンガポールセミナー報告

Report on "The 2nd Singapore-Japan
Microelectronics Packaging Technology Seminar"

岡本 明*

去る7月11日、シンガポールのインペリアルホテルにおいて、標記のセミナーが開催された。このセミナーは、SHMの国際委員会の活動の一環として、シンガポールのこの分野の技術者への最新実装技術の紹介と情報交換とを目的として、SHMとSingapore-ISHMとの共催で、昨年より始まったものである。

Singapore-ISHMは、Mr. C. K. Teo氏が会長をつとめ、会員約70名と小ぶりではあるが人口270万人のシンガポールにとってみてはそれなりの大きさであり、Delco, Philipsなどの現地法人の人たちによって運営されている。

昨年のセミナーは、BGA, CSP, Flip chipなど最新半導体パッケージに絞り込んだのに対し、今年は、接合材料、実装設備等を含め、CSPなどのパッケージとそれらを使用したPDA、ノートパソコンなど幅広い分野をカバーした。

当日のプログラムはTab.1の通りである。

当日の参加者は約130人と大盛況であった。質疑では、シンガポール訛で早口の質問にたじろぐ場面も見受けら

中村 SHM 国際委員会
委員長あいさつ

れたが、活発な応答があり、有意義な会とすることができた。

シンガポールでは、実際に先端技術に触れて仕事をしている技術者の数はあまり多くないと思われるが、最先端を目指そうという意気込みが強く感じられた。近年、シンガポールは強力な指導者リカンユー首相のもとに工

セッション風景

* Akira Okamoto (SHM 理事, 国際委員会副委員長)

TDK ㈱電子デバイス事業本部/Electronic Device Business Group, TDK CORPORATION.

Tab.1

Opening speech
Dr. Yoshikazu Nakamura Professor, National Defence Academy, Japan
Microelectronics Packaging Technology Trends in Japan
Dr. Sei-ichi Denda Executive Director, SHM, Japan
Advanced Equipment and Processes for Microelectronics Packaging
Mr. Mitsuru Ozono, Sr. Engineer, Process Development Group, Production Engineering Laboratory, Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd., Japan
Microsoldering-Solder Precoating Technology by using Super Solder for Very Fine Pitch Soldering
Mr. Masakazu Hamada, General Manager, APD Project Team, Research and Development Division, Furukawa Electric Co., Ltd., Japan
Technological Trends in Passive Components-Miniaturization and Integration
Dr. Akira Okamoto, General Manager, Technology Marketing Dept., Electronic Device Business Group, TDK Corporation, Japan
Advanced Substrate Technology
Professor S. K. Lahiri Institute of Materials Research and Engineering, Singapore
Process Optimisation of Encapsulants and Adhesives used in Plastic IC Packages
Dr. Spencer Chew, Member of Technical Staff, Institute of Microelectronics, Singapore
PDA Using MCM-L Technology
Mr. Hironori Urasawa, Manager, Personal Computer Division, NEC Corporation, Japan
The Meaning of μ-BGA as CPS and its Expecting Application
Dr. Shin-ichi Wakabashi, General Manager, Research and Devt. Division, Shinko Electric Industries Co., Ltd., Japan
Flip Chip MCM for Notebook PC
Mr. Mikio Nishihara, Manager, Packaging Technology Development Dept., Technology Development Div. II, Fujitsu Ltd., Japan
Reliability Practices in Singapore Electronic Manufacturing Industries
Mr. C. K. Teo, President, ISHM-The Microelectronics Society, Singapore Chapter, Singapore
Closing Speech
Mr. C. K. Teo, President, ISHM-The Microelectronics Society, Singapore Chapter, Singapore

業化を推進してきたが、最近になり、エレクトロニクスでは、AV 機器の生産は、東南アジアの周辺国に出ていってしまい、携帯電話、ノートパソコン、HDDといった先端製品に移行しつつある。さらには、ソフト化、サービス業化と進んで行くのであろうが、常に最先端の情

報、技術を取り入れ、将来を生き抜いていこうという指導者の理念が感じられた。

最後に、この紙面をお借りして、本セミナーに寄付をくださった在シンガポール日系企業と、貴重な講演をくださったスピーカーの方々に感謝いたします。